

檔 號：

保存年限：

台灣發明商品促進協會 函

機關地址：台北市松山區八德路二段400號
7樓

承辦人：賴淑玲

電話：02-8772-3898

電子信箱：wiipa168@wiipa.org.tw

受文者：國立臺北大學

發文日期：中華民國113年8月15日

發文字號：台發協字第1130081502號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：(ATTCH3 A095G0000Q0000000_文稿1_0081502A00_ATTCH3.docx、
ATTCH4 A095G0000Q0000000_文稿1_0081502A00_ATTCH4.pdf)

主旨：本協會辦理「2024杜拜DIS國際發明展」，敬請惠予公告
並轉知 貴校師生踴躍參加。

說明：

一、「2024杜拜DIS國際發明展」由杜拜發明協會與世界發明
智慧財產聯盟總會共同舉辦。杜拜作為阿聯酋的經濟中心，已
成為世界商業樞紐，吸引全球創新人才和企業。本屆展覽將展
示創新發明技術，為發明家和企業提供展示與交流的平台，促
進國際合作與商機。

二、展覽日期：113年12月11日至12月13日。

三、展覽地點：杜拜會議中心。

四、聯絡方式：wiipa168@wiipa.org.tw或02-8772-3898賴小姐

正本：國立臺灣海洋大學、國立政治大學、國立臺灣大學、國立臺灣大學計算機及資
訊網路中心、國立臺灣大學生物資源暨農學院附設山地實驗農場、國立臺灣大
學生物資源暨農學院附設農業試驗場、國立臺灣大學生物資源暨農學院附設動
物醫院、國立臺灣大學生物資源暨農學院實驗林管理處、國立臺灣師範大學、
國立陽明交通大學、國立臺北藝術大學、國立臺北教育大學、臺北市立大學、
東吳大學、中國文化大學、世新大學、銘傳大學、實踐大學、大同大學、臺北
醫學大學、康寧學校財團法人康寧大學、國立臺灣戲曲學院、國立臺北護理健

國立臺北大學



1130510436 113/08/16



裝

訂

線

康大學、國立臺北商業大學、國立臺北大學、國立臺灣藝術大學、馬偕學校財團法人馬偕醫學院、輔仁大學學校財團法人輔仁大學、淡江大學學校財團法人淡江大學、華梵大學、真理大學、國立體育大學、國立中央大學、中原大學、長庚大學、元智大學、開南大學、國立清華大學、玄奘大學、中華大學學校財團法人中華大學、國立聯合大學、國立臺中教育大學、國立臺灣體育運動大學、國立中興大學、國立中興大學計算機及資訊網路中心、東海大學、逢甲大學、靜宜大學、中山醫學大學、亞洲大學、國立彰化師範大學、大葉大學、明道學校財團法人明道大學、建國科技大學、國立暨南國際大學、國立嘉義大學、國立中正大學、南華大學、國立臺南藝術大學、國立臺南大學、台灣首府學校財團法人台灣首府大學、中信學校財團法人中信金融管理學院、長榮大學、國立中山大學、國立高雄師範大學、國立高雄大學、義守大學、高雄醫學大學、國立屏東大學、國立金門大學、國立宜蘭大學、佛光大學、國立東華大學、慈濟學校財團法人慈濟大學、國立臺東大學、國立空中大學、高雄市立空中大學

副本：113/08/16
08:25:54

施養隆 會長